

平安证券股份有限公司

关于上海伟测半导体科技股份有限公司

2025 年半年度持续督导跟踪报告

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为承接上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“伟测科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及公开发行可转换公司债券持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责伟测科技的持续督导工作，并出具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	伟测科技已与平安证券签订保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	本持续督导期间，伟测科技未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	本持续督导期间，伟测科技在持续督导期间未发生重大违法违规或违背承诺等事项。
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构在本持续督导期间，与伟测科技保持密切的日常沟通，通过定期或不定期回访、现场检查等方式持续关注伟测科技生产经营、信息披露情况，对伟测科技开展持续督导工作。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	保荐机构承接持续督导工作之后，督导伟测科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范

序号	工作内容	实施情况
		性文件，切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构承接持续督导工作之后，督促伟测科技依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对伟测科技的内部控制度的设计、实施和有效性进行了核查，伟测科技的内部控制制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构承接持续督导工作之后，督促伟测科技严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对伟测科技的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	本持续督导期间，伟测科技及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，伟测科技及其实际控制人不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，经保荐机构核查，伟测科技未出现该等事项
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保	本持续督导期间，伟测科技未发生相关情况。

序号	工作内容	实施情况
	荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	保荐人已制定了对伟测科技的现场检查工作计划，并明确了现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。本持续督导期间，伟测科技不存在需要专项现场检查的情形。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现伟测科技存在需要整改的重大问题。

三、重点风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险因素事项如下：

（一）核心竞争力风险

1、研发与技术人才短缺或流失的风险

集成电路测试行业属于技术密集型产业，测试方案开发、测试量产都依赖于理论知识和工程经验丰富的技术人员。目前，与广阔的市场空间相比，专业测试研发技术人员相对匮乏。此外，同行业竞争对手可能通过更优厚的待遇吸引公司技术人才，同时，公司可能会受其他因素影响导致技术人才流失。上述情况将对公司测试方案的研发以及测试技术能力、测试技术人才的储备造成不利影响，进而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

（二）经营及财务风险

1、公司新建产能消化风险

在无锡、南京购买土地、新建厂房并配置相关测试设备，重点购置“高端芯片测试”及“高可靠性芯片测试”相关机台。无锡项目和南京项目均已投入使用，

未来还计划投资南京二期项目和成都项目。由此，公司产能规模，尤其是“高端芯片测试”及“高可靠性芯片测试”产能规模得到进一步提升。虽然公司投资项目的下游市场容量大、增速高，为项目的实施提供了市场保障，同时公司已经结合市场前景、公司技术、客户等方面储备情况对投资项目的具体规划产能进行了充分的可行性论证，但若未来出现下游行业景气程度降低、公司市场开拓不利、公司研发、技术迭代或市场需求不及预期、市场竞争加剧等重大不利因素，且公司未能采取有效措施应对，则公司新增产能可能存在不能被及时消化的风险。

2、进口设备依赖的风险

报告期内，公司产能持续扩张，固定资产投资规模持续增长。公司现有机器设备以进口设备为主，主要供应商包括 Advantest(爱德万)、Teradyne(泰瑞达)、Semics 等国际知名测试设备厂商。公司进口设备主要是测试机、探针台、分选机及相关配件，是公司测试业务的关键设备。截至目前，公司现有进口设备及募集资金投资项目所需进口设备未受到管制。若未来国际贸易摩擦特别是中美贸易冲突加剧，美国进一步加大对半导体生产设备的出口管制力度和范围，从而使公司所需的测试设备出现进口受限的情形，将对公司生产经营产生不利影响。

3、主营业务毛利率下降的风险

公司主营业务毛利率与产能利用率、测试设备折旧、人力成本、市场供需关系等经营层面变化直接相关。同时，由于公司测试平台及配置种类较多，不同平台和配置的单价及成本差异较大，因此平台和配置的结构变化也会对公司主营业务毛利率产生较大影响。若未来上述因素发生不利变化比如产能利用率下降、设备折旧增加、人力成本上升或市场需求萎缩导致服务价格下降、成本上升，则公司主营业务毛利率可能出现下降的风险。

4、技术更新不及时与研发失败风险

随着集成电路行业自身的发展以及下游产品更新迭代的速度加快，高性能、多功能的复杂 SoC 以及各类先进架构和先进封装芯片（Chiplet、Sip 等）渐成主流，公司研发的测试方案需要不断满足高端芯片对测试的有效性、可靠性、稳定性以及经济性的需求，研发难度大大增加。此外，客户的测试需求也在不断变化，

各类定制化要求层出不穷，公司要随之更新测试技术以适应市场的变化。如果公司未能在技术研发上持续投入，未能吸引和培养更加优秀的技术人才，可能存在研发的测试方案或开发的测试技术不能达到新型芯片产品的测试指标，导致研发失败的风险，进而对公司的经营造成不利影响。

5、核心技术泄密风险

经过多年的技术创新和研发积累，公司的测试方案开发能力与测试技术水平跻身国内先进行列。与此同时，公司十分重视对核心技术的保护工作，制定了包括信息安全保护制度在内的一系列严格完善的保密制度，并和核心技术人员签署了保密协议，对其离职后做出了严格的竞业限制规定，以确保核心技术的保密性。但由于技术秘密保护措施의 局限性、技术人员的流动性及其他不可控因素，公司仍存在核心技术泄密的风险。如上述情况发生，可能在一定程度上削弱公司的技术优势并产生不利影响。

（三）行业风险

随着集成电路测试需求的不断扩大，独立第三方测试企业和封测一体化企业等各类测试服务商继续扩大产能、增加投入，市场竞争变得日趋激烈。若公司未来无法在上述几个方面不断缩小与封测一体化企业和独立第三方测试头部企业之间的差距，将有可能在竞争中处于不利地位。

（四）宏观环境风险

近年来，全球主要经济体贸易摩擦持续升温，全球贸易环境恶化，全球经济发展存在极大不确定性，对我国集成电路行业造成一定的冲击。截至目前，公司现有进口设备及投资项目所需进口设备尚未受到进口“卡脖子”管制及使用限制。公司始终严格遵守中国和其他国家的法律，但国际局势瞬息万变，一旦贸易政策、关税、出口限制、其他贸易壁垒进一步恶化，使得我国部分产业发展及半导体行业生态链受到冲击，公司可能面临设备采购限制和下游客户需求下降等风险，进而导致公司生产受限、订单减少、成本增加，对公司的业务和经营产生不利影响。

公司所处行业为技术密集型、资金密集型行业，受宏观政策、宏观经济形势等因素影响，并且与下游行业及宏观经济周期密切相关。宏观经济下行的风险或

将对公司所处行业造成冲击，短期内造成下游客户需求疲软，或有可能影响公司相关业务的开展。

四、重大违规事项

本持续督导期间，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025 年半年度，公司主要财务数据如下表所示：

（一）主要会计数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

主要会计数据	2025 年 1—6 月	2024 年 1—6 月	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	634,252,628.82	429,915,232.67	47.53
利润总额	102,673,574.38	2,249,127.85	4,465.04
归属于上市公司股东的净利润	101,078,388.85	10,856,629.28	831.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,717,284.25	4,217,706.33	1,173.61
经营活动产生的现金流量净额	339,442,813.28	202,407,009.95	67.70
主要会计数据	2025 年 6 月末	2024 年年末	本报告期末比上年度末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	2,729,708,316.07	2,619,076,189.03	4.22
总资产	6,319,420,224.72	4,919,016,975.28	28.47

（二）主要财务指标

主要财务指标	2025年1—6月	2024年1—6月	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元 / 股）	0.68	0.10	580.00
稀释每股收益（元 / 股）	0.68	0.10	580.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.36	0.04	800.00
加权平均净资产收益率（%）	3.78	0.44	增加 3.34 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.01	0.17	增加 1.84 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	12.95	15.00	减少 2.05 个百分点

（三）主要会计数据和财务指标的变动说明

今年上半年以来，随着 AI 相关产品不断渗透、国产替代加速推进、先进封装测试需求激增且得益于公司扩大高端测试产能的前瞻性策略与高效运营，公司整体产能利用率不断提高，规模效应进一步释放利润空间，公司业务结构优化和盈利质量得到双提升。

公司 2025 年上半年实现营业收入 6.34 亿元，同比增长 47.53%，其中，公司第二季度实现营业收入 3.50 亿元，单季度营收创出历史新高。2025 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 10,107.84 万元，较上年同期增长 831.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,371.73 万元，较上年同期增长 1,173.61%。

公司今年上半年营收与利润实现强劲增长主要源于以下几个方面：一是在市场开拓、结构优化、成本控制、研发转化及产能效率提升等方面的举措成效显著；二是去年同期受行业下滑需求疲软影响，业绩基数相对较低；三是股份支付费用较去年同期大幅下降。

六、核心竞争力的变化情况

（一）核心竞争力分析

1、人才优势

公司的核心团队深耕集成电路行业二十余年，是国内最早从事集成电路测试的一批资深人士，曾参与建立了中国大陆最早的晶圆测试工厂威宇科技测试封装（上海）有限公司。团队主要成员曾先后在摩托罗拉、日月光、长电科技等全球知名半导体企业或封测龙头企业从事测试业务技术研发和管理工作，拥有深厚的专业背景，对测试技术研发、测试方案开发、量产导入、精益生产、测试产线自动化管理有着丰富的实践经验，并且在市场研判、行业理解等方面具备领先于同行业的洞察力。公司亦高度重视研发人才的培养与引进。截至 2025 年 6 月 30 日，公司研发与技术人员占比超 20%，主要研发人员平均从业年限在 6 年以上，强大的研发团队保障了公司在技术方面的领先地位。公司不断健全公司长效激励机制，制定了多期限限制性股票激励计划以吸引和留住优秀人才。

2、技术优势

公司自创立之初就定位于专业的独立第三方集成电路测试服务商，通过技术研发和工艺升级提高测试服务的品质是公司始终的诉求。公司的技术先进性主要体现在测试方案开发能力强、测试技术水平领先和生产自动化程度高三个方面。在测试方案开发方面，公司突破了 5G 射频芯片、高性能 CPU 芯片、高性能算力芯片、FPGA 芯片、复杂 SoC 芯片等各类高端芯片的测试工艺难点，成功实现了国产化。在测试技术水平方面，公司在晶圆尺寸覆盖度、温度范围、最高 Pin 数、最大同测数、Pad 间距、封装尺寸大小、测试频率等参数上保持国内领先，并与国际巨头持平或者接近。在测试作业的自动化方面，公司对标国际巨头，通过将测试作业中积累的技术和经验融入 IT 信息系统，自主开发了符合行业特点的生产管理系统，提升了测试作业的信息化、自动化、智能化水平，提高了测试作业的准确率和效率。

3、客户优势

公司作为独立第三方测试企业没有封装业务，只有测试业务，因此能够从中立客观的角度公正地向客户呈现测试的客观结果，在此方面更易获得客户的认可。公司持续加大研发投入，重点突破各类高端芯片的测试工艺难点，成为大陆各芯片设计公司高端芯片测试的自主可控的重要供应商之一。公司的技术实力、服务品质、产能规模获得了行业的高度认可，积累了广泛的客户资源。

公司的客户包括了集成电路设计公司、晶圆制造企业、IDM 企业和封装企业，公司营业收入中占比较大的客户为集成电路设计公司，公司客户超过 200 家，其中高端芯片设计公司出于对其自身测试服务需求的把控、成本控制以及风险控制，将为其提供测试业务供应商的选择由境外转向境内。

4、产能规模优势

集成电路测试行业具有“大者恒大”的客观规律，除了备受重视的研发投入规模以外，测试产能规模是集成电路测试企业的核心竞争力之一。充足的产能规模能够吸引客户的重视，是接受行业内高端测试客户订单的必要条件。足够的测试产能还能让公司在行业处于相对上行的周期时快速响应客户的测试需求，在行业处于相对下行的周期时保证一定的生产规模，从一定程度上抵消行业波动对经营产生的不良影响。此外，目前国内大部分测试厂商定位中低端市场，在复杂和高端产品的测试能力上相对欠缺，故高端测试产能相对紧缺；而进行高端测试需使用高端测试设备，这些设备采购价格较高，交付周期相对较长，且相关设备的研发及生产长期被海外巨头垄断，每年供给的数量相对有限。

与同行业公司相比，公司十分重视产能规模尤其是高端测试产能的建设。基于公司自身战略规划考量、兼顾不同客户的不同测试需求、集成电路行业新产品和终端应用对产品的需求和要求，以及对行业整体发展的认知，2025 年公司稳步实施扩产计划，继续购入爱德万 V93000、泰瑞达 UltraFlex Plus、泰瑞达 UltraFlex 等高端测试相关设备。截至目前，公司的产能规模，尤其是高端测试产能规模在中国大陆独立第三方测试企业中处于相对优势水平，高端测试设备数量在中国大陆行业领先。在此基础上，公司进一步夯实了公司在中国大陆独立第三方测试企业中的行业领先地位。

5、区位优势

公司拥有上海、南京、无锡和深圳四个测试基地。公司以长三角市场和珠三角市场为双引擎，连接全球半导体产业链（设计、制造、设备），覆盖中高端制造集群，贴近终端客户，有利于快速响应客户对晶圆测试及芯片成品测试的需求、有利于降低芯片运输损耗与时间成本，有利于灵活调配产能与缩短供应链周期。同时，长三角和珠三角人才储备充足、高校资源丰富，公司在人才招聘上有着巨大优势。最后，长三角和珠三角各地区在产业政策和招商引资上也存在着丰富的优势。为进一步扩大市场占有率，公司于 2025 年 6 月对外披露投资成都的计划。公司将通过成都项目完善全国战略布局，填补西南区域空白，以此形成覆盖长三角、珠三角、环渤海和西南地区的全国性服务网络。

（二）核心竞争力的变化情况

2025 年 1-6 月，伟测科技的持续竞争力未发生重大不利变化。

七、研发投入及变化情况

（一）研发投入情况

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	82,133,746.35	64,499,142.60	27.34
资本化研发投入	-	-	
研发投入合计	82,133,746.35	64,499,142.60	27.34
研发投入总额占营业收入比例（%）	12.95	15.00	减少 2.05 个百分点

（二）研发进展

1、报告期内研发成果

2025 年 1-6 月，公司研发工作有序推进，新获得发明专利 2 项、软件著作权 11 项。截至 2025 年 6 月末，公司累计获发明专利 18 项、实用新型专利 86 项、软件著作 85 项。

2、在研项目情况

2025 年 1-6 月，公司在研项目情况如下：

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标
1	新兴 5.5G 射频前端芯片晶圆测试方案开发	研发阶段	利用 93K 和 Chroma 平台开发新兴 5.5G 射频前端芯片晶圆的测试方案，形成通用的测试软硬件方案和测试代码，并积累相应的基础测试数据和项目经验，为以后类似产品实际量产开发提供数据指导。
2	车规级 SOC 芯片晶圆及成品测试方案开发	研发阶段	开发车规级 SOC 芯片的晶圆及成品测试方案，确保芯片的功能、性能和可靠性。为公司未来在汽车电子测试提供相关的技术支持和方案支持，以确保公司未来在汽车电子测试领域保持竞争力和话语权。

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标
3	高性能 ChipLet 芯片 成品测试方案 开发	研发阶段	Chiplet 有利于降低设计的复杂度和设计成本，同时也有望降低芯片制造的成本，但是 Chiplet 对测试的挑战会进一步上升，例如测试流程控制以及各类高速接口测试。公司旨在迎接 Chiplet 对测试的挑战，不断开发新的测试技术和测试方案，以确保公司未来在先进测试领域保持持续竞争力。
4	车规电机驱动 MCU 的晶圆 测试开发解决 方案	研发阶段	实现车规级电机驱动 MCU 的高效晶圆测试 ATE 解决方案开发，满足新能源车迅猛发展所带来的对高性能电机驱动芯片的需求。
5	高功率芯片测试 基于芯片 UID 实时测试 流程参数级测试 回溯系统	研发阶段	通过芯片 UID 实现测试全流程参数的实时追踪与回溯，精准定位测试异常，提升问题排查效率，保障测试数据可追溯性，为高功率芯片质量管控提供数据支撑，满足汽车电子、工业控制等领域对测试数据溯源的严苛要求，助力高可靠性芯片产品研发与量产。
6	基于自动图像 识别芯片信息 测试全流程应用 系统	研发阶段	利用自动图像识别技术，实现芯片信息的自动提取与匹配，贯穿测试全流程，减少人工干预，提高测试准确性和效率。
7	OPUS 测试机 台智能化自动 升级管控平台	研发阶段	实现 OPUS 测试机台的自动化升级与管控，包括软件版本更新、参数配置优化等，减少停机时间，保障机台稳定运行，提升半导体测试产线的设备管理水平。
8	93K 测试机数 据参数级建模 智能分析平台	研发阶段	对 93K 测试机的测试数据进行参数级建模，通过智能分析算法挖掘数据价值，优化测试参数，提升测试良率和效率。
9	Chroma 测试 机测试脚本智 能化开发部署 平台	研发阶段	实现 Chroma 测试机测试脚本的自动化开发、调试与部署，缩短脚本开发周期，提高脚本复用率和可靠性。
10	J750 测试机与 OPUS 测试机 台协同测试平 台	研发阶段	构建 J750 与 OPUS 测试机台的协同工作机制，实现数据共享与任务协同，提升多机台联合测试的效率和一致性，提高测试产线的整体产能。
11	产线测试设备 开发测试流程 智能监控系统 平台	研发阶段	对产线测试设备的开发及测试流程进行实时智能监控，及时预警异常情况，优化流程节点，提升设备利用率和测试稳定性，助力产线智能化管理和效率提升

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标
12	成品芯片测试 智能化管理 (二期)	研发阶段	在一期基础上扩大覆盖至全部测试基地，实现备件预测性维护，降低维护成本40%，提升整体设备效率（OEE）5%。
13	AI 视觉智能检测在 IC 测试中应用	研发阶段	实现芯片外观全自动检测，替代人工目检，检测效率提升 200%，经过训练后准确率 99.8%以上。
14	IC 测试良率提升自动化分析系统	研发阶段	实现测试良率的自动根因分析，快速定位问题，提升产品良率。
15	晶圆测试机台效率自动化管理	研发阶段	实现晶圆测试机台的自动化调度与效率优化，提升设备利用率 20%，减少机台闲置时间，优化测试资源配置，提升整体产能。
16	智能仓储系统在 IC 测试领域的应用	研发阶段	实现测试芯片的自动化存储、调度和送料，减少人工搬运，提升仓储效率 50%，支持 7x24 小时无人化运作
17	基于 chroma 平台的车规低成本测试方案的研发（一期）	研发阶段	利用 Chroma 平台在车规集成电路低成本测试方案的研发，研发全新的测试方案，测试流程，以及对应的技术手段降低车规集成电路对测试平台的要求，以实现测试覆盖率和测试成本之间取得最优的平衡。以满足未来车规集成电路对于测试的多样化要求。
18	域控制器芯片基于 93K 平台的测试方案开发	研发阶段	通过高性能计算芯片整合多个 ECU 功能，降低复杂度与成本，中央计算+区域控制，实现跨域功能协同；稳定三温三压 FT/CP 测试程序。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况是否合规

（一）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目		金 额
募集资金净额		116,298.33
截至期初累计发生额	项目投入（包含置换预先投入金额）	

项 目		金 额
	利息收入、理财收益净额	
本期发生额	项目投入（包含置换预先投入金额）	97,892.76
	利息收入、理财收益净额	28.05
截至期末累计发生额	项目投入（包含置换预先投入金额）	97,892.76
	利息收入、理财收益净额	28.05
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 ^{【注】}		18,433.62

注：

1、上表为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户的使用和结余情况，公司首次公开发行股票募集资金已按规定全部使用完毕，全部募集资金专户均已注销完毕。

2、截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户余额包含购买理财产品尚未到期金额 10,000.00 万元。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

账户名称	银行名称	银行账号	余额(万元)
上海伟测半导体科技股份有限公司	兴业银行上海大柏树支行	216380100100420264	2.72
	中信银行上海分行	8110201011501885643	5.04
	交通银行上海张江支行	310066865013009418191	10,289.44 ^{【注】}
无锡伟测半导体科技有限公司	招商银行股份有限公司无锡分行	511903003310018	7,573.04
南京伟测半导体科技有限公司	交通银行股份有限公司南京鼓楼支行	320006600013004712605	563.38

注：该募集专户余额包含截至 2025 年 6 月 30 日购买理财尚未到期金额 10,000.00 万元。

综上，2025 年上半年度，公司募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股、质押、冻结及减持情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司控股股东为上海蕊测半导体科技有限公司，持有公司 45,685,496 股股份，持股比例为 30.87%。公司于 2025 年 6 月 18 日完成公司 2024 年年度权益分派方案：以方案实施前的公司总股本 114,159,795 股为基数，每股派发现金红利 0.34 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，2025 年 1-6 月，公司控股股东持股数量相应增加 10,542,807 股，其股份不存在质押、冻结或减持情况。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况如下：

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
骈文胜	董事长、总经理、核心技术人员	21,276	53,109	31,833	股权激励归属及公积金转股
闻国涛	董事、副总经理、核心技术人员	17,022	42,489	25,467	股权激励归属及公积金转股
路峰	董事、副总经理、核心技术人员	17,022	42,489	25,467	股权激励归属及公积金转股
王沛	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	12,766	31,866	19,100	股权激励归属及公积金转股
刘琨	副总经理、核心技术人员	10,639	26,555	15,916	股权激励归属及公积金转股

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

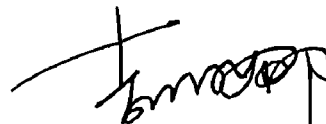
无。

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



牟 军



吉丽娜

